

## Industry

## Drive Technologies

Für die Fachpresse

Nürnberg, 3. Juni 2008

## SMT Hybrid Packaging 2008

### **Siplace sichert europäischen Elektronikfertigern mehr Flexibilität und Qualität**

**Sein auf die Anforderungen der europäischen Elektronikfertiger zugeschnittenes Angebot präsentiert Siemens auf der diesjährigen Messe SMT/Hybrid/Packaging (SMT) in Nürnberg. Schwerpunkte bilden das Spitzenmodell Siplace X4i, die derzeit schnellste 4-Portal-Bestücklösung am Markt, und die ebenso leistungsstarken wie kostengünstigen Automaten der Siplace D-Serie. Sie zeichnen sich aus durch hohe Bestückqualität und ausgesprochene Flexibilität bei kleinen und mittleren Losgrößen. Siplace-Experten zeigen, wie sich mit Software und Services stillstandsfreie Produktwechsel, Prozessqualitäten von 0 dpm (Defects per Million) und schnellste Produktneueinführungen realisieren lassen. Messebesucher können über „Compare“-Checklisten alle relevanten Leistungs- und Kostenaspekte mit den Angeboten anderer Hersteller vergleichen.**

Mit der Siplace X4i präsentiert Siemens auf der SMT in Nürnberg den aktuellen Weltrekordhalter bei der realen Bestückleistung: mehr als 102.000 Bauelemente pro Stunde (BE/h) – gemessen nach internationalen IPC-Standards. Das entspricht 120.000 BE/h nach Siplace-Benchmark und einer theoretischen Bestückleistung von 135.500 BE/h. Wichtig für europäische Elektronikfertiger: Die Siplace X4i kombiniert diese Leistungskraft mit hoher Flexibilität, beispielsweise per synchronem oder asynchronem Doppeltransport, intelligenten X-Bauteilförderern, Productivity Lane und i-Placement.

Für Elektronikfertiger im mittleren Marktsegment bietet sich die Siplace D-Serie mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis bei gleichzeitig hoher Qualität an. So verfügt

1 / 3

die D-Plattform über das gleiche digitale Visionsystem wie die Highend-Automaten der X-Serie. Über das gesamte Bauteilspektrum – bis hinunter zu den superkleinen 01005-Komponenten der nächsten Generation – arbeiten die Siplace D-Automaten effizient und mit höchster Bestückgenauigkeit.

Ein weiteres Highlight der Messe-Präsentation von Siemens ist die Siplace-Compare-Initiative, die schon im Vorfeld von Investitionsentscheidungen wertvolle Hilfe für Elektronikfertiger anbietet. Herstellerübergreifend und objektiv können Elektronikfertiger mittels „Compare“-Checklisten die Leistungs- und Kostenaspekte von Lösungen zur Elektronikfertigung vergleichen. Berücksichtigt werden dabei alle Parameter zur Entscheidungsfindung, auf Basis von internationalen IPC-Standards.

Außerdem erfahren Elektronikfertiger in Nürnberg, wie sich Bauelemente neuer Produkte über die externe Siplace Vision-Teaching-Station schnell und fehlerfrei beschreiben lassen und Bestückprogramme offline und – ohne Rückgriff auf die produktiven Linien – erstellt und optimiert werden können. In Kombination mit den Siplace-Kalibrierservices kann man auf diese Weise schon kurz nach Produktionsstart Prozessqualitäten von 0 dpm erreichen und dauerhaft sichern. Im Bereich Software zeigt Siemens in einer Live-Demonstration, wie die Siplace LES-Software auch bei kleinen Losgrößen erstmals stillstandsfreie Rüstwechsel ermöglicht und so die Produktivität der Linie maximiert.

Für den Bereich Dienstleistungen gibt Siemens auf der SMT Einblick in das vielseitige Angebot: Es reicht von Traceability-Konzepten über Calibration Services und Feeder Care bis hin zu kundenspezifischen Rundum-Sorglos-Paketen.

Weitere Informationen zu Siplace unter: [www.siplace.com](http://www.siplace.com)

Sie finden den Text auch im Internet unter: [www.siemens.de/automation/press](http://www.siemens.de/automation/press)

Ein Bild ergänzt diese Pressemitteilung. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: [www.siemens.com/ad-bild/1684](http://www.siemens.com/ad-bild/1684)



Das Spitzenmodell Siplace X4i, die derzeit schnellste 4-Portal-Bestücklösung der Welt, und die ebenso leistungsstarken wie kostengünstigen Automaten der Siplace D-Serie stellen auf der SMT/Hybrid/Packaging 2008 ihre hohe Bestückqualität und enorme Flexibilität bei kleinen und mittleren Losgrößen unter Beweis.

---

Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: [www.siemens.com/ad-bild/1684](http://www.siemens.com/ad-bild/1684)

Leseranfragen unter dem Kennzeichen „IDTEA200806.1684d“ bitte an:

Siemens Industry Drive Technologies

Electronics Assembly Systems

Susanne Oswald

E-mail: [susanne.oswald@siemens.com](mailto:susanne.oswald@siemens.com)